

KPMG

毕马威

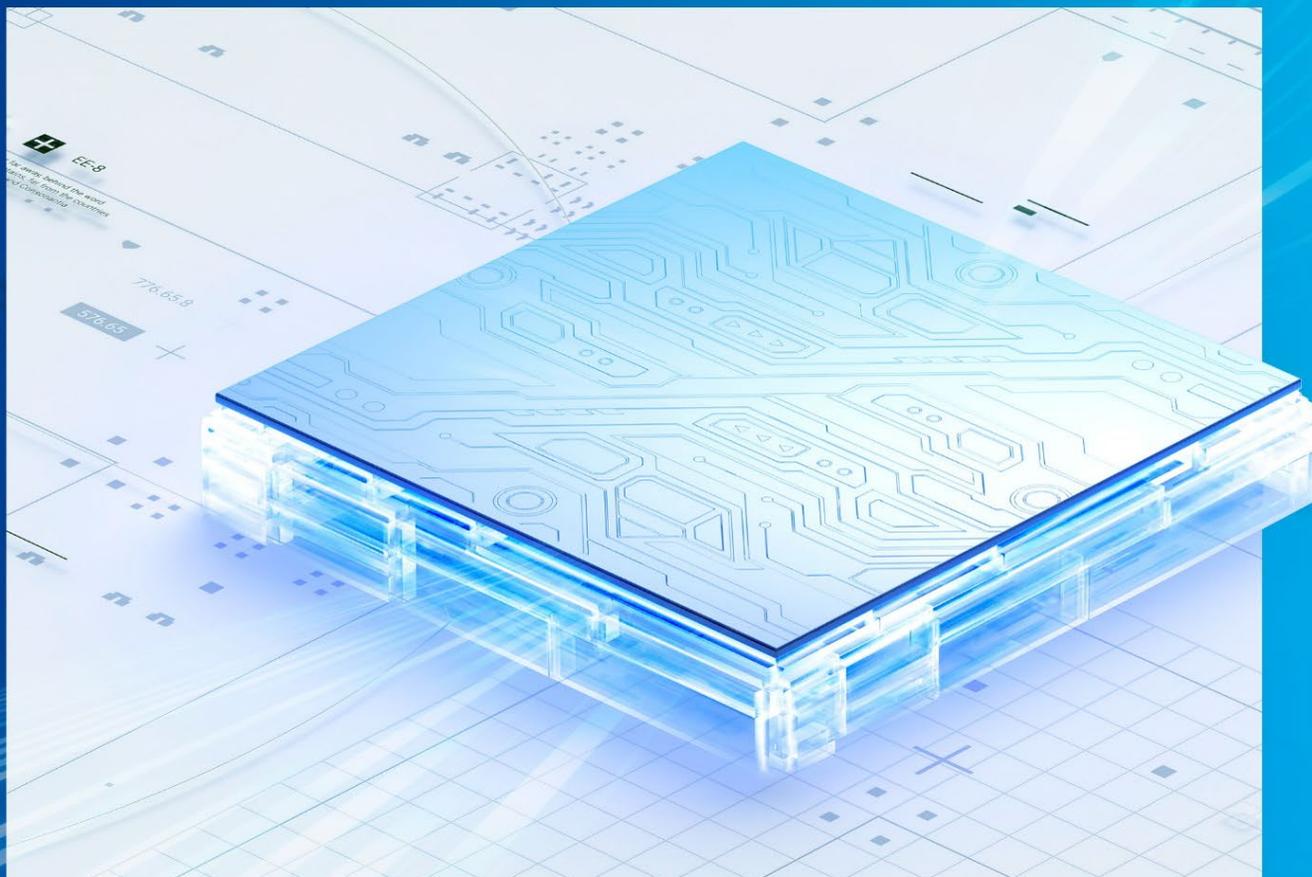
中国“芯科技” 新锐企业50报告(第四届)



毕马威中国未来行业50榜单系列
KPMG China Future Sector 50 Ranking Series



芯科技
Chiptech



毕马威中国

kpmg.com/cn

关于毕马威

毕马威中国在三十一个城市设有办事机构，合伙人及员工超过15,000名，分布在北京、长春、长沙、成都、重庆、大连、东莞、佛山、福州、广州、海口、杭州、合肥、济南、南京、南通、宁波、青岛、上海、沈阳、深圳、苏州、太原、天津、武汉、无锡、厦门、西安、郑州、香港特别行政区和澳门特别行政区。在这些办事机构紧密合作下，毕马威中国能够高效和迅速地调动各方面的资源，为客户提供高质量的服务。

毕马威是一个由独立的专业成员所组成的全球性组织，提供审计、税务和咨询等专业服务。毕马威国际有限公司（“毕马威国际”）的成员所以毕马威为品牌开展业务运营，并提供专业服务。“毕马威”可以指毕马威全球性组织内的独立成员所，也可以指一家或多家毕马威成员所。

毕马威成员所遍布全球143个国家及地区，拥有超过265,000名专业人员。各成员所均为各自独立的法律主体，其对自身描述亦是如此。各毕马威成员所独立承担自身义务与责任。

毕马威国际有限公司是一家英国私营担保有限责任公司。毕马威国际及其关联实体不提供任何客户服务。

1992年，毕马威在中国内地成为首家获准开业的中外合作会计师事务所。2012年8月1日，毕马威成为四大会计师事务所之中首家从中外合作制转为特殊普通合伙的事务所。毕马威香港的成立更早在1945年。率先打入市场的先机以及对质量的不懈追求，使我们积累了丰富的行业经验，中国多家知名企业长期聘请毕马威提供广泛领域的专业服务（包括审计、税务和咨询），也反映了毕马威的领导地位。

免责声明

本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供，亦并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础。任何人士或团体在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。

本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，所有企业介绍均由上榜企业自行提供，毕马威对介绍所含信息的准确性不作保证。除前述免责声明外，毕马威亦不承担本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何默示担保，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。

读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件和 / 或其所包含的全部或部分信息有关的任何损失或损害，包括但不限于任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。

倘若本免责声明的任何部分因任何原因无效或不能完全执行，其余部分内容仍然有效。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 卷首语 | 01 |
| 毕马威中国“未来 50”系列榜单 | 03 |
| 毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 介绍 | 04 |
| 毕马威中国半导体行业系列活动 | 05 |
| 毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 榜单 | 06 |
| 半导体行业发展趋势 | 07 |
| 附件 | 10 |
| 附件一 半导体行业政策法规更新 | 10 |
| 附件二 毕马威中国“芯科技”50 评选团队 | 13 |
| 附件三 毕马威半导体行业洞察 | 14 |

卷首语



杨洁

毕马威中国副主席
毕马威中国
华东及华西区
首席合伙人

半导体产业是信息技术行业的基石，是科技发展的核心。在2019年的进博会上，毕马威中国启动了第一届“‘芯科技’新锐企业 50”评选活动，深度洞见芯片领域的前沿态势，把脉半导体行业的技术演进与创新。今年，第四届“‘芯科技’新锐企业 50”评选榜单如期而至，毕马威联合内外部多领域的专家进行调研和探讨，以公开、公正、公平的评价标准进行评估，旨在促进中国半导体领域的发展以及助力优质企业的成长。

当前，全球半导体产业正处于周期性的调整变革阶段，供应链、人才和政治风险等方面挑战不断，我国的半导体行业面临着前所未有的战略机遇期，成熟制程持续扩产，国产化进程正加速推进。毕马威市场调研显示：尽管预计增速放缓，但行业高管仍对收入增长持乐观态度。随着半导体行业产品供应正在趋于平衡，芯片短缺即将结束。值得关注的是，得益于汽车制造商加速电动汽车生产，自毕马威发布半导体行业报告以来，汽车行业今年首次被认为是驱动半导体公司收入增长最重要的动力。总体来看，尽管存在短期动荡，行业前景依旧光明。本届“芯科技”50除了关注既往的芯片领域中高成长企业，还首次将“半导体设备及零部件”纳入评选企业的维度，为评选榜单注入新的活力，亦将促进科技创新、高附加值的企业获得更高的市场关注度。

毕马威作为领先的专业服务机构，持续深耕半导体行业，密切跟踪行业的更新迭代。我们始终致力于为客户提供审计、税务、咨询等多位一体的专业服务和解决方案。同时，毕马威也期待与更多的行业内企业携手共进，一道洞察发展机遇，共同推进产业转型升级。



陈俭德

毕马威中国
科技、媒体及通信行业
主管合伙人

近年来，我国数字经济蓬勃发展，规模总量稳居全球第二，已然成为稳增长促转型的重要引擎。作为电子信息行业的压舱石，半导体行业正深刻影响着各行各业的数字化发展，加速整个半导体行业应用端的自我创新。同时，数据中心、生成式AI以及大语言模型的算力需求显著增长，新兴产业布局亦在反向推动半导体产业的设计、研发进程，助力企业构建全面的数字孪生。

后疫情时代下，受经济增速放缓、技术管制等诸多因素的影响，半导体制造商正经历短期的行业动荡，随着周期底部渐显，库存去化持续推进，叠加下游需求缓慢复苏，行业周期向上指日可待。中国半导体行业正逐步攻克先进制程设备的技术壁垒，提升核心材料、零部件的自主可控能力，创新驱动芯片国产化的市场份额不断扩张，丰富汽车、消费电子、云计算、物联网、人工智能等终端市场的数字化应用场景，以韧性应对行业发展中的不确定性。

作为科技的制高点，半导体行业的技术演进不仅关乎着整个产业链的发展前景，也是综合国力竞争的关键一环。加快突破关键芯片及设备领域的技术、实现高端核心技术国产化已成为产业升级的必由之路。本土企业应蓄力赋能，与时代共振向上，推动半导体产业向高标准、高效能、高质量方向发展。



李吉鸣

毕马威中国
半导体行业
审计主管合伙人

半导体行业辐射范围广、产业带动作用强。纵观全球半导体的产业迁移，美、日、韩等主要经济体借力半导体实现产业转型，深刻地影响了全球半导体产业的分工与布局。把握第三次半导体产业转移浪潮，创新发展战略、推动技术迭代、实现产业赶超成为后摩尔时代下中国半导体产业发展的要旨。

随着库存去化、消费需求复苏、价格回弹，中国半导体产业正告别寒冬，迎接新的机遇与挑战。从技术路径上看，传统集成电路正经历着工艺逼近物理极限、研发与生产成本高昂的发展瓶颈，先进封装及Chiplet正推动新技术演进，探寻异质异构集成的颠覆性发展路径；从运营管理上看，半导体产业链环节多且长，存在高度的互联互通。我国在光刻、量测检测、离子注入等方面存在进口依赖，随着外部贸易环境变化，倒逼本土企业推进半导体全产业链的国产替代，打造稳定、可靠的供应链网络；从发展战略上看，作为技术驱动型的行业，半导体对从业人员的经验积累、行业认知有较高的要求，如何培养并聚集高素质复合型人才成为企业竞争的战略高地。

在国家政策的强力加持下，各级政府从产业协调、财税补贴、融资渠道等方面，持续优化半导体产业的营商环境。同时，随着ChatGPT、新能源汽车等应用场景的爆火，资本也在源源不断地涌入，为半导体行业蓄势储能。毕马威中国此次携第四届“芯科技”50榜单再度归来，坚持以专业的服务和全球化的视野，为企业搭建并拓宽发展赛道，助力打造具有国际影响力的第三代半导体产业群。

毕马威中国 “未来 50” 系列榜单



金融科技
Fintech



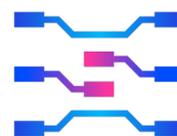
汽车科技
Autotech



生物科技
Biotech



消费科技
Retailtech



芯科技
Chiptech



医疗健康
Healthcare



不动产科技
PropTech



消费50
Consumer Brands 50



文创科技
CultureTech



新能源科技
New Energy Tech

在现今竞争激烈的全球化市场中，所有公司都经历着前所未有的转变。为了帮助企业洞察行业、看清未来，毕马威中国希望通过未来行业50榜单系列，为企业清晰呈现行业洞察，化洞察为机遇，协助客户解决在各自行业中面临的巨大挑战。毕马威与全球各行业顶尖公司合作，在审计、税务和咨询方面均拥有经验丰富且实力雄厚的行业团队，以专业视角洞察行业及市场，并凭借丰富项目经验为客户提供最优质的服务，助力企业洞察当下、把握未来。

商场如赛场，行业如赛道。毕马威中国推出涵盖金融、汽车、生物、消费、芯片、医疗健康、地产、政府及能源等行业的“未来行业50”榜单系列，旨在根据企业身处的不同生命周期，引导他们做出契合其发展的战略选择，并帮助行业及资本遴选未来赛道上的明星企业。同时，毕马威提出以“未来行

业50赛道”的概念，持续为企业搭建并拓宽各行业赛道。

自推出以来，毕马威“未来行业50”榜单系列始终坚持以专业性、公平性和平台性为三大特点，不断扩大各行业网络的内外连接，并最终增加行业生态系统的整体价值。评选过程由毕马威联合内外部专家共同组成评选委员会，从团队、技术、产品、市场、融资等多个维度，以公开、公正、公平的评价标准对企业进行评估。

我们希望毕马威“未来行业50”榜单系列成为这样一个提供行业赛道的平台，为企业带来更多的市场机遇，持续助力行业创新变革，共同揭示行业深刻洞察，预见行业未来。

毕马威中国“芯科技” 新锐企业 50 介绍

毕马威作为拥有全球网络的专业服务机构，持续深耕科技行业。我们观察到技术演进在中国芯片领域正带来更多的模式创新和技术创新。

为促进中国芯片领域的发展以及为该领域内企业的成长提供支持，继 2020 年发布首届毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 评选后，毕马威中国设立“芯科技”新锐企业 50 榜单，至今已开启四届评选活动。

毕马威“芯科技”新锐企业 50 榜单，针对中国芯片领域内致力于推进通信终端及网络、感知系统、数字处理及逻辑运用、物联网实体应用、半导体材料

以及半导体设备及零部件的高成长企业，通过线上模型和线下专家团队综合评选机制，评选优质创业企业。

此外，为了加强对创业企业的支持，降低规模及资本对评选结果的影响，本次评选暂不考虑已经上市的公司。

本次评选不收取任何费用。

注：
我们推出中国“芯科技”新锐企业评选活动，旨在加强市场对芯片科技领域技术创新的关注，推动行业交流，促进芯片科技的良性发展，并非对参评企业合规性与可投资性进行评价，也不涉及对任何监管政策的解读。本次评选不收取任何费用，特此说明。

评委会组成

我们的评审委员会由多领域专家组成，包括：毕马威行业专家及合伙人、中国芯片领域领军企业、半导体协会、人工智能行业联盟及科研领域的专家学者等。

评选过程

评委实地访谈、调研备选企业，更全面、翔实地掌握了第一手资料，确保榜单的客观、公正和严谨。



参选条件

- 企业在中国芯片领域具有创新性，包括以下六个维度：
 - 通信终端及网络
 - 感知系统
 - 数字处理及逻辑运用
 - 物联网实体运用
 - 半导体材料
 - 半导体设备及零部件
- 持续经营 12 个月及以上
- 非上市公司

核心评价维度

- 技术和商业模式的创新
- 估值与资本市场认可
- 半导体行业协会认可度
- 市场认可度
- 财务健康状况
- 团队能力

评选方法

1. 案头调研 (Desktop research)

基于毕马威对芯片设计行业的长期观察，提炼该行业的生态现状

2. 实地访谈 (Field interview)

毕马威中国“芯科技”50 团队对报名企业进行实地走访，访谈企业创始人及高管团队

3. 专家访谈 (Experts interview)

通过对行业领军企业的高管、科研领域的专家学者等业内专家进行访谈，听取业内人士对行业及细分领域的认知与见解

4. 数据模型分析 (Data analysis)

采用毕马威自主开发的创业企业洞察力模型 SIP，对企业进行评估

毕马威中国 半导体行业系列活动

毕马威中国的半导体行业小组是四大会计师事务所中唯一实现审计、税务、咨询一体化的半导体行业专项小组。该小组由各业务部门中具备丰富半导体行业服务经验的精英专家组成，小组成员遍布全国各主要城市，以便在必要时向客户提供目标明确的行业经验和专业建议。这些专家在半导体行业中拥有深厚的专业知识和实践经验，能够准确把握市场动态和客户需求，为客户提供个性化的解决方案，能够为企业、基金投资、园区创立发展的全生命周期提供相关解决方案，与客户共同成长。

过去一年里，我们举办了多场主题交流会，邀请行业内的专家、学者和企业代表分享最新的技术、市场趋势和业务经验。同时我们积极参与各类论坛和行业峰会，与行业精英、专家学者和企业代表进行深入的交流和探讨。通过这些活动，我们能够及时获取最新的行业信息和发展动态，拓宽视野，提升专业素养和服务水平。我们积极分享我们的专业知识和经验，与业界同行共同探讨半导体行业的未来发展趋势和挑战。

芯科技50评选



港交所18C规则研讨会
- 上海场



2023年7月PE专题培训



2022年11月
某汽车半导体峰会



2022年11月解读
“全球半导体行业展望”



2023年4月集成电路
供应链相关培训会



2023年6月
某半导体产业峰会

毕马威中国“芯科技” 新锐企业 50 榜单

| 企业简称 | 企业简称 | 企业简称 |
|---------|--------------|-------------|
| 爱芯元智 | 聆思科技 | 芯来科技 |
| 安森德 | 迈姆思 | 芯启源 |
| 翠展微电子 | 莘芯科技 | 芯瑞微 PhySim |
| 滴翠智能 | KiwiMoore | 芯享科技 |
| FabXLab | 清纯半导体 | 芯易荟 |
| 光鉴科技 | 上海治精微电子有限公司 | 星逻智能 |
| 后摩智能 | 深迪半导体 | 亿铸科技 |
| 华合德 | 时擎科技 | 益思芯科技 |
| 杰平方 | SynSense时识科技 | 涌现科技 |
| 金阵微电子 | 视海芯图 | 遇贤微电子 |
| 瑜捷电子 | 舜铭存储 | 元络芯 |
| 酷芯微电子 | 苏州纳生微电子 | 云德材料 |
| 奎芯科技 | 图灵量子 | 泽丰 |
| 利普思半导体 | 犀灵视觉 | 肇观电子NextVPU |
| 凌锐半导体 | 曦智科技 | 志行聚能 |

* 以上名单按照企业简称首字母顺序排序，排名不分先后。

注：我们推出中国“芯科技”新锐企业评选活动，旨在加强市场对芯片科技领域技术创新的关注，推动行业交流，促进芯片科技的良性。

半导体行业发展趋势

2022 年半导体产业的发展趋势主要呈现为以下几个方面：

一 种种挑战下，半导体行业仍将机遇大于挑战

宏观经济因素、供需失衡、人才和政治风险目前令全球半导体行业面临的主要压力。尽管如此，根据过往一年我们的半导体行业系列活动的研究结果显示，半导体行业前景光明，依然对全球经济、基础设施、各类产品和服务的重要性占据着支配地位。半导体行业高管在各自公司看到了增长潜力，并清楚地认识到，即使周期性调整已经开始，但是半导体行业长期仍然具备顽强的生命力，将继续增长。2023年芯片制造商通过积极谋划，运用战略眼光，并加大投资，将以韧性应对各种不确定性。

尽管行业高管普遍乐观，但相比于去年几乎所有高管（95%）预测公司收入增长，今年他们的预期较低。在半导体行业生态系统内，对经济衰退的担忧、地缘政治受关注度增加、供应链风险以及全球通胀上升等一系列新因素正在压低行业高管的预期，尽管总体而言，大多数行业高管持乐观态度，81%的高管预计未来一年公司的收入将有所增长。

与今年相比，您对贵公司明年收入增长有何预期？



■ 提高 ■ 下降 ■ 不变

资料来源：KPMG Global Semiconductor Industry Outlook Survey

生态系统内的压力因素正在对今年行业整体前景产生更大的影响，而成本压力则是导致市场情绪下降的主要潜在因素。面对资本、材料和劳动力成本上涨，行业增长和盈利预测呈现些许不确定。

根据我们的调查，收入增长并未全部转化为利润增长，主要是因为芯片制造商自己吸收了供应链中的价格上涨，没有全部传递给客户。

而支出方面，全球通货膨胀和利率上升是影响半导体公司2023年支出计划的重大因素。62%的行业高管预计本公司在设备和软件方面的资本支出将比去年有所增加。只有15%的行业高管计划削减资本支出。

与本年度支出相比，您如何看待贵公司未来一年半半导体相关资本支出（包括设备和软件）？



■ 提高 ■ 下降 ■ 不变

资料来源：KPMG Global Semiconductor Industry Outlook Survey

71%还预计将扩大公司的全球员工队伍，为了提高产能，建造新的晶圆代工厂，并为新工厂的员工提供薪酬更高的专业岗位。尽管在任何经济环境下，增加员工都会导致经营成本上升，但考虑到当前的工资增幅和竞争激烈的人才市场，经营成本可能升至新高。

未来一年，您预计贵公司的全球员工人数会增加还是减少？



■ 提高 ■ 下降 ■ 不变

资料来源：KPMG Global Semiconductor Industry Outlook Survey

二 芯片供应链问题仍然存在

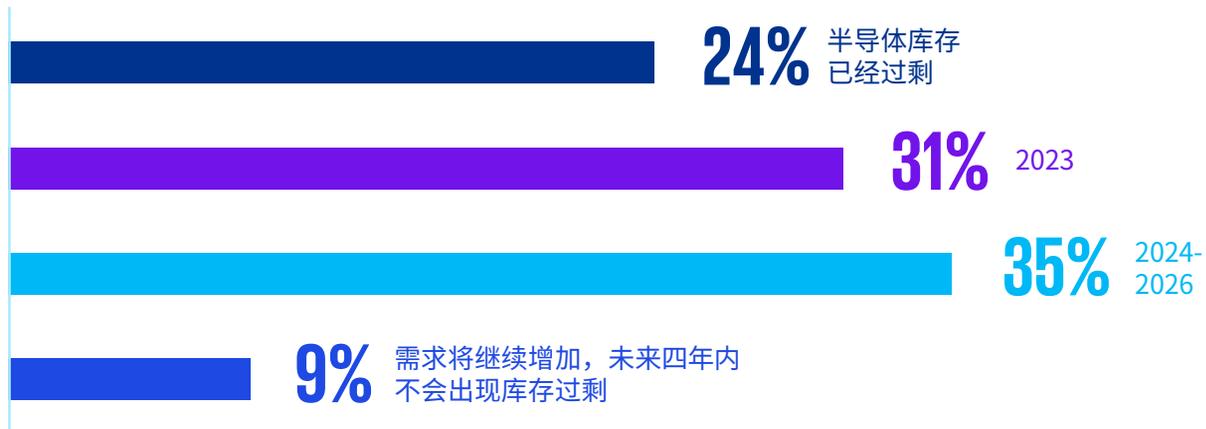
全球范围内的半导体供应链问题仍然存在，对芯片的生产和供应产生了一定的影响。事实上，行业正在从产品稀缺的环境转变为以库存过剩为主要特征的环境，目前内存市场就是例证。然而，另一方面，新兴应用领域如人工智能、物联网、5G通信等对半导体芯片的需求不断增加，也为半导体行业提供了市场空间和机遇。

由于半导体行业具有周期性，针对“下一次半导体库存过剩会在何时发生”这一问题，在2023年毕马威全球半导体行业展望的报告中显示：四分之一（24%）的行业高管认为库存已经过剩，31%的行业高管认为2023年会出现库存过剩，35%的行业高

管认为库存过剩将在2024年至2026年期间出现，9%的行业高管认为需求将继续增长，未来四年内不会出现库存过剩。

他们观点不一致也反映了一个事实：我们的研究结果呈现的是宽泛的行业观点，但行业高管对供应不足或过剩的预期可能因产品线、板块和应用场景而异。生态系统中的一些领域（例如内存）存在巨大的供应过剩，而其他板块（例如向汽车等不断增长的终端市场供应产品的板块）仍在逐步摆脱供应不足的影响。

下一次半导体库存过剩会在何时发生？



资料来源：KPMG Global Semiconductor Industry Outlook Survey

三 汽车行业是半导体行业收入增长的首要驱动力

半导体行业增长与汽车电动化和自动驾驶日益紧密相连。自毕马威发布半导体行业报告以来，汽车行业今年首次被认为是驱动半导体公司收入增长最重要的动力。在各类应用场景中，汽车的重要性排名最高。助推这种情绪的因素包括电动汽车（被认为比燃油汽车更清洁、更安全）的日益普及，从而也带动更加强劲的汽车芯片需求。毕马威的相关研究预测，到2030年代中期，汽车半导体的年收入将达到2,000亿美元，到2040年将超过2,500亿美元。

随着汽车占据头号地位，无线通讯——长期以来被视为芯片制造商最关键的终端市场——滑落至第二位。与此同时，云计算从第五位上升至第三位，目

前与物联网并列为第三大收入来源。

我们的研究还表明，围绕终端市场调整组织架构对于半导体公司的发展战略日益重要。越来越多的公司开始以终端市场而不是产品为参照来确定发展方向。

为了确保在半导体再次短缺的情况下拥有制造关键部件所需的芯片供应，汽车等高增长行业的制造商正在与芯片制造商建立更直接的关系，包括在更长的期限内认购更高的产量，以及更积极参与实际的芯片开发。芯片公司则正在围绕此类新合作关系进行组织重组，以更好地管理成本和风险。

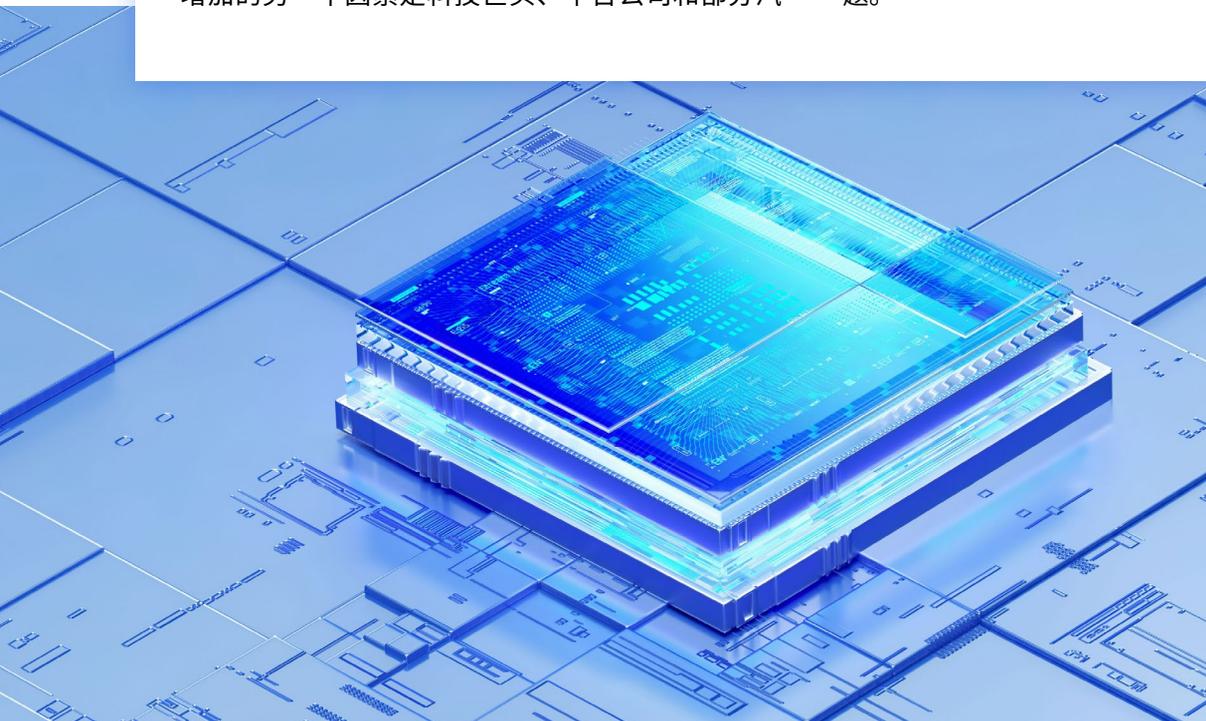
四 人才再次成为最大的行业问题和战略重点

从芯片技术专家、工程师和设计师到后台员工和项目经理，再到制造厂和晶圆代工厂工人，人力资源是保持全球半导体生态系统运行的关键。人才来源问题是半导体行业2023年及以后关注的重点。

半导体公司面临主要的挑战是，市场上具备芯片和配套软件设计专业技能的人才不足。导致人才风险增加的另一个因素是科技巨头、平台公司和部分汽

车公司正在纷纷开发自己的芯片和硅片制造能力。大型科技公司与传统芯片制造商争夺专业人才，导致市场上人才供应短缺。

根据我们的研究，人才是半导体行业高管群体中热度最高的话题。人才风险（包括熟练工人短缺、吸引和留住人才难）是半导体行业未来三年的头等问题。



半导体行业 政策法规更新

| 发布时间 | 文件号 | 名称 | 发布机构 | 网址 |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 2023.09.12 | 财政部 税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部公告 2023年第44号 | 关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告 | 财政部，税务总局，国家发展改革委，工业和信息化部 |  |
| 2023.01.19 | 苏政规〔2023〕2号 | 关于进一步促进集成电路产业高质量发展的若干政策 | 江苏省人民政府办公厅 |  |
| 2023.01.03 | 工信部联电子〔2022〕181号 | 工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见 | 工业和信息化部，教育部，科学技术部，中国人民银行，中国银行保险监督管理委员会，国家能源局 |  |
| 2022.12.30 | 浙经信软件〔2022〕245号 | 浙江省集成电路产业链标准体系建设指南（2022年版） | 浙江省经济和信息化厅，市场监督管理局 |  |
| 2022.10.11 | | 深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施（征求意见稿） | 深圳市发展和改革委员会 |  |
| 2022.06.23 | 济政办发〔2022〕3号 | 关于促进集成电路产业发展的意见 | 济南市人民政府办公厅 |  |
| 2022.06.06 | | 深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022-2025年） | 深圳市发展和改革委员会，科技创新委员会，工业和信息化局，国有资产监督管理委员会 |  |
| 2022.03.17 | | 广州市半导体与集成电路产业发展行动计划（2022-2024年） | 广州市工业和信息化局 |  |

半导体行业 政策法规更新

| 发布时间 | 文件号 | 名称 | 发布机构 | 网址 |
|------------|----------------------------------|---|-------------------------------|---|
| 2022.03.14 | 发改高技〔2022〕390号 | 关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知 | 发展改革委工业和信息化部 财政部海关总署税务总局 |  |
| 2022.03.14 | | 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 十三届全国人大四次会议批准通过 |  |
| 2021.03.22 | 财关税〔2021〕5号 | 关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策管理办法 | 财政部，发展改革委，工业和信息化部，海关总署，税务总局 |  |
| 2021.01.15 | 工信部电子〔2021〕5号 | 基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年） | 工业和信息化部 |  |
| 2020.12.11 | 财政部，税务总局发展改革委，工业和信息化部公告2020年第45号 | 关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告 | 财政部税务总局发展改革委工业和信息化部 |  |
| 2020.08.04 | 国发〔2020〕8号 | 国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知 | 国务院 |  |
| 2019.10.30 | 国家发展和改革委员会令 第29号 | 产业结构调整指导目录（2019年本） | 国家发展和改革委员会 |  |
| 2018.03.28 | 财税〔2018〕27号 | 关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知 | 财政部，国家税务总局，国家发展和改革委员会，工业和信息化部 |  |

半导体行业 政策法规更新

| 发布时间 | 文件号 | 名称 | 发布机构 | 网址 |
|------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 2018.03.28 | 国发〔2016〕73号 | “十三五”国家信息化规划 | 国务院 |  |
| 2016.11.29 | 国发〔2016〕67号 | “十三五”国家战略性新兴产业发展规划 | 国务院 |  |
| 2015.05.08 | 国发〔2015〕28号 | 中国制造 2025 | 国务院 |  |
| 2015.03.02 | 财税〔2015〕6号 | 关于进一步鼓励集成电路产业发展企业所得税政策的通知 | 财政部，国家税务总局，国家发展和改革委员会，工业和信息化部 |  |
| 2012.04.20 | 财税〔2012〕27号 | 关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知 | 财政部，国家税务总局 |  |
| 2011.01.28 | 国发〔2011〕4号 | 国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知 | 国务院 |  |
| 2001.04.02 | 国务院令第三百号 | 集成电路布图设计保护条例 | 国务院 |  |
| 2000.06.24 | 国发〔2000〕18号 | 国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知 | 国务院 |  |

毕马威中国 “芯科技” 50 评选团队

| | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|------------------|
| 李吉鸣 Jamie Li | 毕马威中国 半导体行业审计主管合伙人 | 周琳 Lynn Zhou | 毕马威中国 审计服务合伙人 |
| 张欢 Charles Zhang | 毕马威中国北方区 半导体行业审计主管合伙人 | 邵锋 Tony Shao | 毕马威中国 审计服务合伙人 |
| 陈怡 Cathy Chen | 毕马威中国华南区 半导体行业审计主管合伙人 | 胡世达 Will Hu | 毕马威中国 审计服务合伙人 |
| 方海杰 Jay Fang | 毕马威中国华东及华西区 生物科技行业与消费品行业 审计主管合伙人 | 郑佳 Amber Zheng | 毕马威中国 咨询服务合伙人 |
| 房灵 Wing Fong | 毕马威中国华南区 高科技及生命科学行业 主管合伙人 | 章晨伟 Jesse Zhang | 毕马威中国 审计服务合伙人 |
| 王威杰 Jerry Wang | 毕马威中国 咨询服务合伙人 | 黄晓冬 Jeff Huang | 毕马威中国 审计服务合伙人 |
| 刘侨敏 Josie Liu | 毕马威中国 审计服务合伙人 | 廖雅芸 Kelly Liao | 毕马威中国 税务服务合伙人 |
| 刘婧媛 Sophie Liu | 毕马威中国 审计服务合伙人 | 谭伟 Wayne Tan | 毕马威中国 税务服务合伙人 |
| 吴惠煌 Spencer Wu | 毕马威中国 审计服务合伙人 | 黄昕 Tom Huang | 毕马威中国 审计服务合伙人 |
| 吕欣潔 Jelena Lu | 毕马威中国 审计服务合伙人 | 李涤非 Aaron Li | 毕马威中国 税务服务合伙人 |
| 李艳艳 Vicky Li | 毕马威中国 审计服务合伙人 | | |

毕马威 半导体行业洞察

The timeline features a central horizontal line with circular nodes at the top and bottom. Vertical lines connect these nodes to various report covers and QR codes. The reports are arranged in a staggered fashion, alternating between the top and bottom of the timeline.

- 2023年02月**
Navigating short-term volatility in the semiconductor industry
2023年02月
- 2022年11月**
中国“芯科技”新锐企业50报告(第三届)
2022年11月
- 2022年11月**
毕马威中国半导体行业关键服务产品手册
2022年11月
- 2022年11月**
创新致远 明智之选
毕马威中国半导体行业产品服务Talkbook
2022年11月
- 2022年10月**
2022年全球半导体行业展望
2022年10月
- 2022年9月**
中美贸易摩擦背景下供应链转型升级白皮书
2022年9月
- 2021年11月**
中国“芯科技”新锐企业50报告(第二届)
2021年11月
- 2021年04月**
五部委联合发布集成电路企业或项目、软件企业清单管理程序、条件和标准
2021年04月
- 2021年02月**
“十四五”规划行业影响展望——科技篇
2021年02月
- 2020年11月**
中国“芯科技”新锐企业50报告(第一届)
2020年11月

联系我们



李吉鸣

Jamie Li

毕马威中国

半导体行业审计主管合伙人

+86 (21) 2212 2558

jamie.li@kpmg.com



张欢

Charles Zhang

毕马威中国北方区

半导体行业审计主管合伙人

+86 (10) 8508 7305

charles.h.zhang@kpmg.com



陈怡

Cathy Chen

毕马威中国华南区

半导体行业审计主管合伙人

+86 (20) 3813 7906

cathy.y.chen@kpmg.com



毕马威

毕马威中国

kpmg.com/CN/socialmedia



如需获取毕马威中国各办公室信息，请扫描二维码或登陆我们的网站：
<https://home.kpmg/cn/zh/home/about/offices.html>

所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料，但本所不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。

© 2023毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。